

#### 1. 適用範囲

本規格は、プリント基板とシャーシ部材等との接続に用いられるアース用金具、シールドフィンガー 1715 について規定する。

#### 2. 適用規格

以下の規格を本規格の一部として適用する。

JIS (Japanese Industrial Standard: 日本工業規格)

#### 3. 適用型番

本規格は、以下の製品型番に対して適用される。

型番: 0-1447360-9

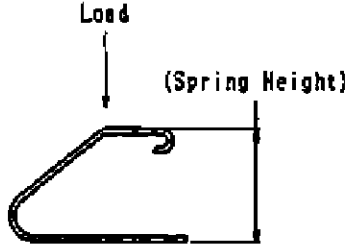
旧型番: 3100069

#### 4. 材 質

金属材料: JIS C1720R ベリリウム銅 (ミルハードン材)

メッキ: ニッケル下地金メッキ 0.05  $\mu\text{m}$  MIN. (前めっき)

5. TEST PROCEDURES AND PERFORMANCE

No.	Title	Test Procedures	Performance
5.1	Mechanical Performance		
5.1.1	Spring Capacity	<p>Measure the spring force, after making 10 times flexion to take one's position at 2mm/min. speed.</p> 	<p>As spring height 1.4 mm Spring Force: 0.2N (20gf) min.</p>

番号	項目	試験方法	性能						
5.2	実装適合性								
5.2.1	半田付性	<p>JIS C0050に基づき、下記の条件で試験を行う。</p> <table border="1" data-bbox="604 359 1209 534"> <tr> <td>半田温度</td> <td>235±5℃</td> </tr> <tr> <td>半田浸漬時間</td> <td>2±0.5 秒</td> </tr> <tr> <td>フラックス</td> <td>NA-200</td> </tr> </table>	半田温度	235±5℃	半田浸漬時間	2±0.5 秒	フラックス	NA-200	<p>・半田付け部の75%以上が新しい半田コーティングで覆われること。(破断面は除く)</p>
半田温度	235±5℃								
半田浸漬時間	2±0.5 秒								
フラックス	NA-200								

---

SHIELD FINGER 1715  
シールドフィンガー 1715

---

注記) 5 ページ以降日本語版

1. Scope

This specification applies to the SHIELD FINGER 1715 which is used for grounding terminal between a printed wiring board and a metal frame.

2. Relevant Standards

The standards below are applicable as part of this specification.

JIS (Japanese Industrial Standard)

3. Types

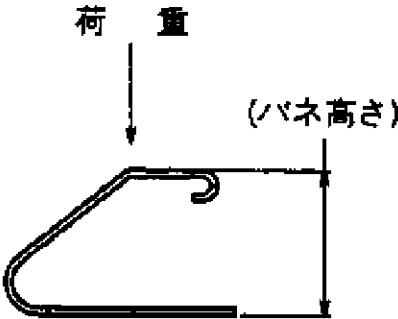
Part No. : 0-1447360-9 Old Part No. 3100069

4. Material

Contact: Beryllium Copper Alloy (JIS C1720R)

Plating: Gold Plate 0.05  $\mu$ m MIN. Over Nickel Plate

5. 試験方法及び性能

番号	項目	試験方法	性能				
5.1	機械的性能						
5.1.1	バネ特性	<p>試料に図示の方向から所定のバネ高さまでたわみを繰り返し与え、試験後のバネ圧を測定する。</p> <table border="1" data-bbox="667 443 1120 529"> <tr> <td>繰返速度</td> <td>2mm/min.</td> </tr> <tr> <td>繰返回数</td> <td>10回</td> </tr> </table> 	繰返速度	2mm/min.	繰返回数	10回	<p>バネ高さ1.4 mmの時      バネ圧: 0.2N(20gf)min.</p>
繰返速度	2mm/min.						
繰返回数	10回						

No.	Title	Test Procedures	Performance				
5.2	Process Compatibility Requirements						
5.2.1	Solderability	<p>The solderability test shall be performed per JIS C0050.</p> <table border="1" data-bbox="506 440 1301 557"> <tr> <td data-bbox="506 440 1010 496">Melted solder Temperature</td> <td data-bbox="1010 440 1301 496">235 ± 5°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 496 1010 557">Immersion Time in Solder</td> <td data-bbox="1010 496 1301 557">2 ± 0.5 sec.</td> </tr> </table>	Melted solder Temperature	235 ± 5°C	Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.	<p>The solder tails shall have been covered with new solder over a minimum of 75% of the solderable area.</p>
Melted solder Temperature	235 ± 5°C						
Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.						